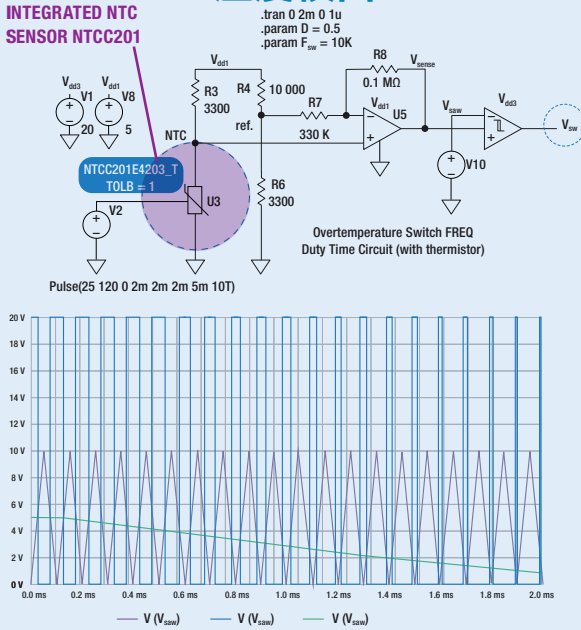




強化されたワイヤボンディングNTCダイ IGBTモジュール内部の温度検出用に設計

IGBTゲートドライバ 温度検出

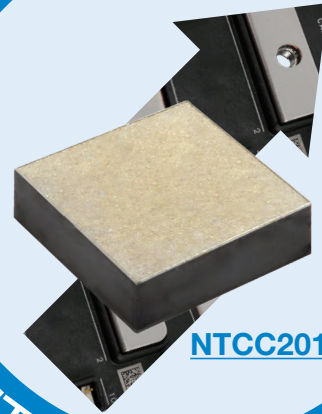


メタライゼーションを 強化した設計

- 厚い電極
- SAC / 高融点はんだ付け
- ギ酸を使用したフラックスフリーはんだ付けに対する耐性



卓越性を追求



NTCC201

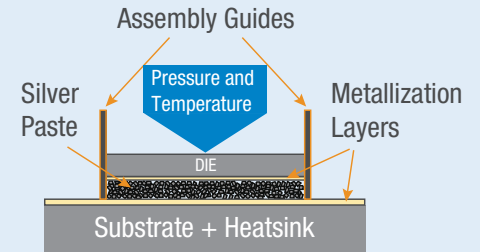
NTCC200の強化版

業界

- EV、ハイブリッド車用のパワーモジュール
- バック・ブーストDC/DCコンバータ
- 風車装置、ソーラーパネル用のインバータ



ワイヤボンディング、 ナノ銀ペースト焼結に対応



高温下(175°C)で高精度/ 高安定性を実現

Drift in operation at 175 °C

